

2023年3月期第2四半期 決算説明会

2022年11月16日

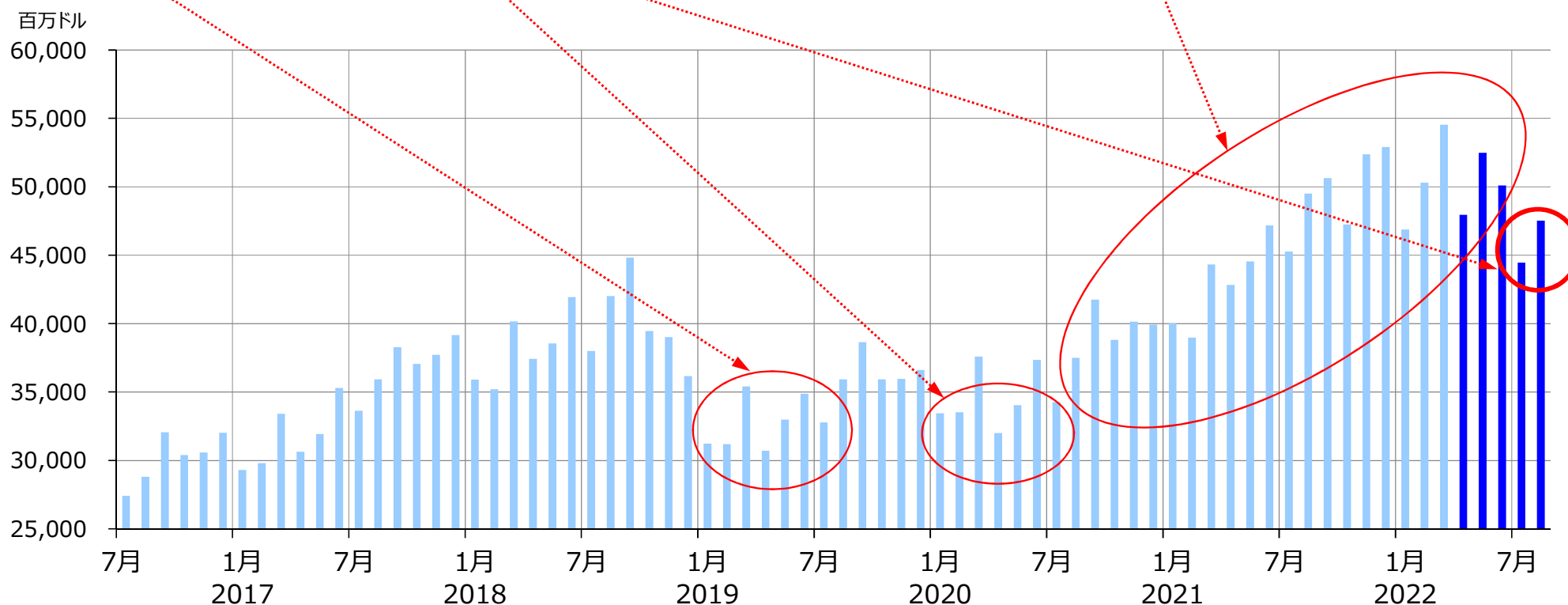
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2022年8月まで）

出所：WSTS（2022/10）

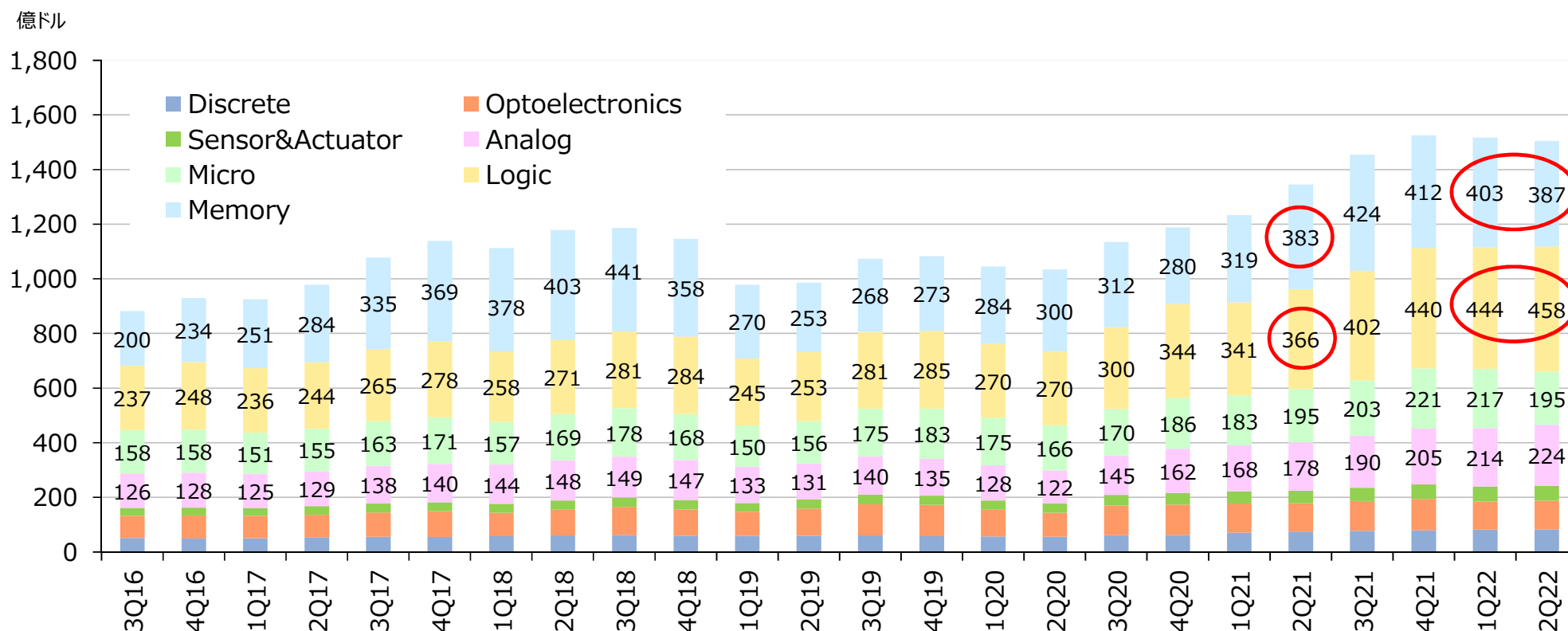
- 2019年、メモリバブルの反動で1月から7月まで半年ほど低迷した後、北米、中国を中心に回復
- 2020年、新型コロナの影響で1月より再び下降 同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- 2022年、7月8月は前年同期比で減少



世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

- 2022年4-6月期の世界半導体市場：ロジックは伸長(QoQ + 3%, YoY +25%)、メモリは調整局面(QoQ - 4%, YoY + 1%)

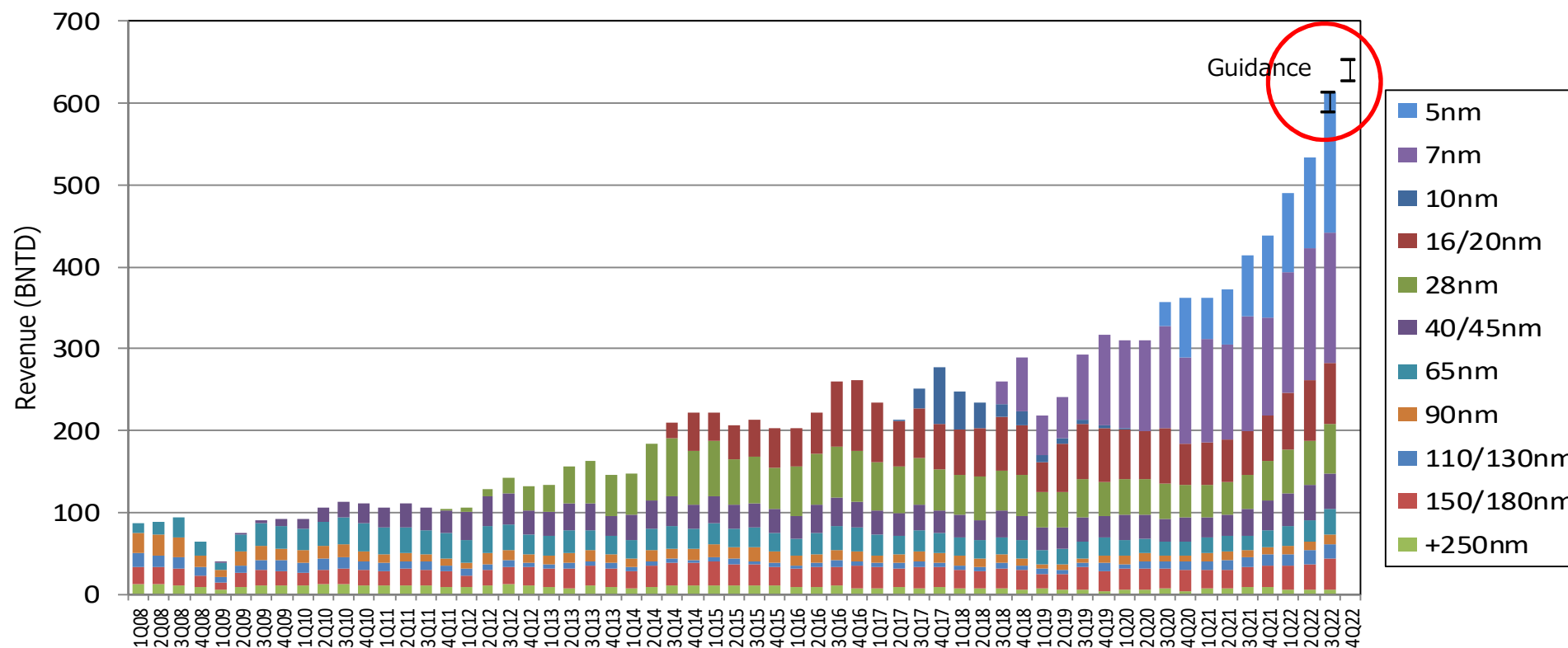


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2022年7-9月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

- 22年1Q（1-3月期）に続き、2Q（4-6月期）3Q（7-9月期）いずれも売上高は過去最高を更新
- 22年4Q（10-12月期）も過去最高を更新見込（ガイダンスベース）
- 22年3Q（7-9月期）のNode別売上高は、7nmプロセスが微減（QoQ -2%）
- 2022年の設備投資を下方修正（400億米ドル→360億米ドル）

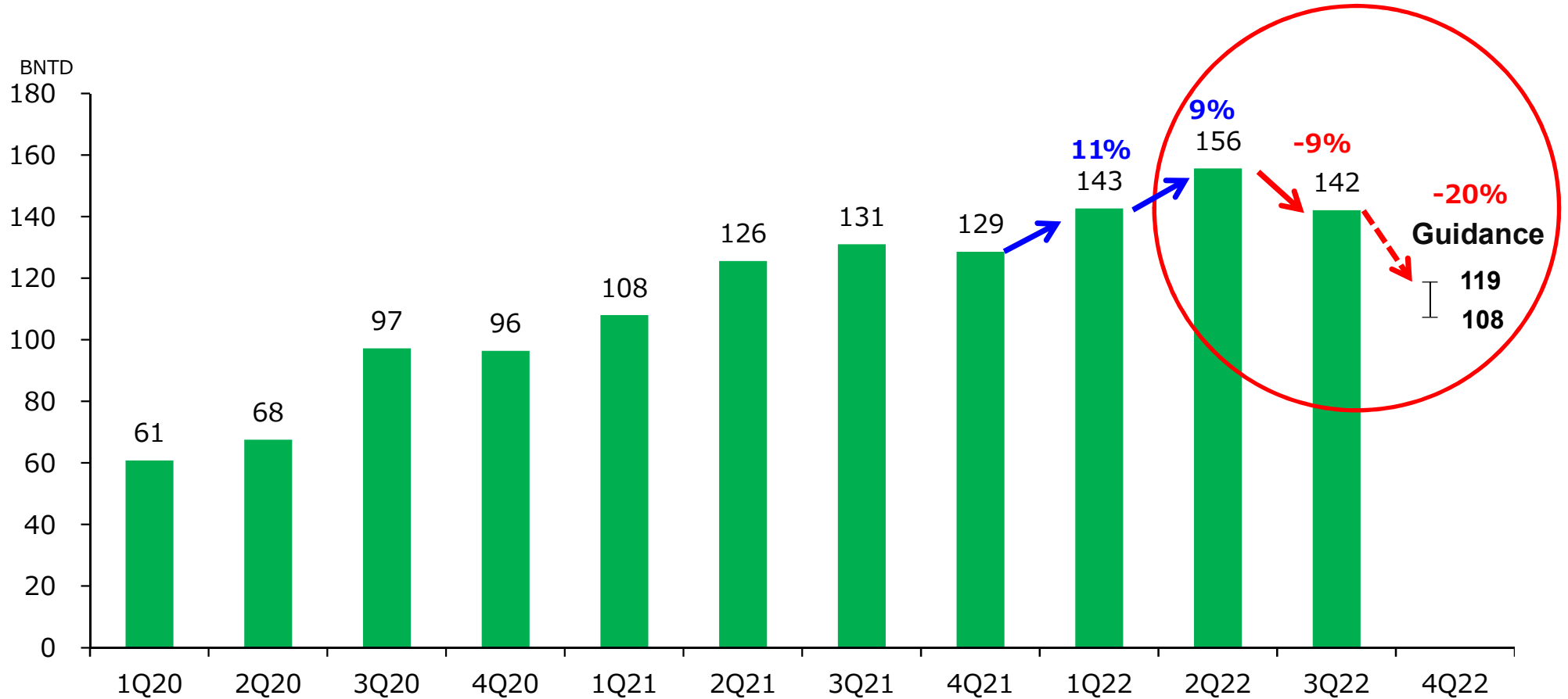


《暦年ベース》

メディアテック 売上高 (2022年7-9月期)

出所：メディアテック公開情報よりフジミ作成

- スマホ向け製品の在庫調整に伴い、22年3Q（7-9月期）の売上高はQoQ -9%
- 22年4Q（10-12月期）のガイダンスでは、売上高はQoQ -20%

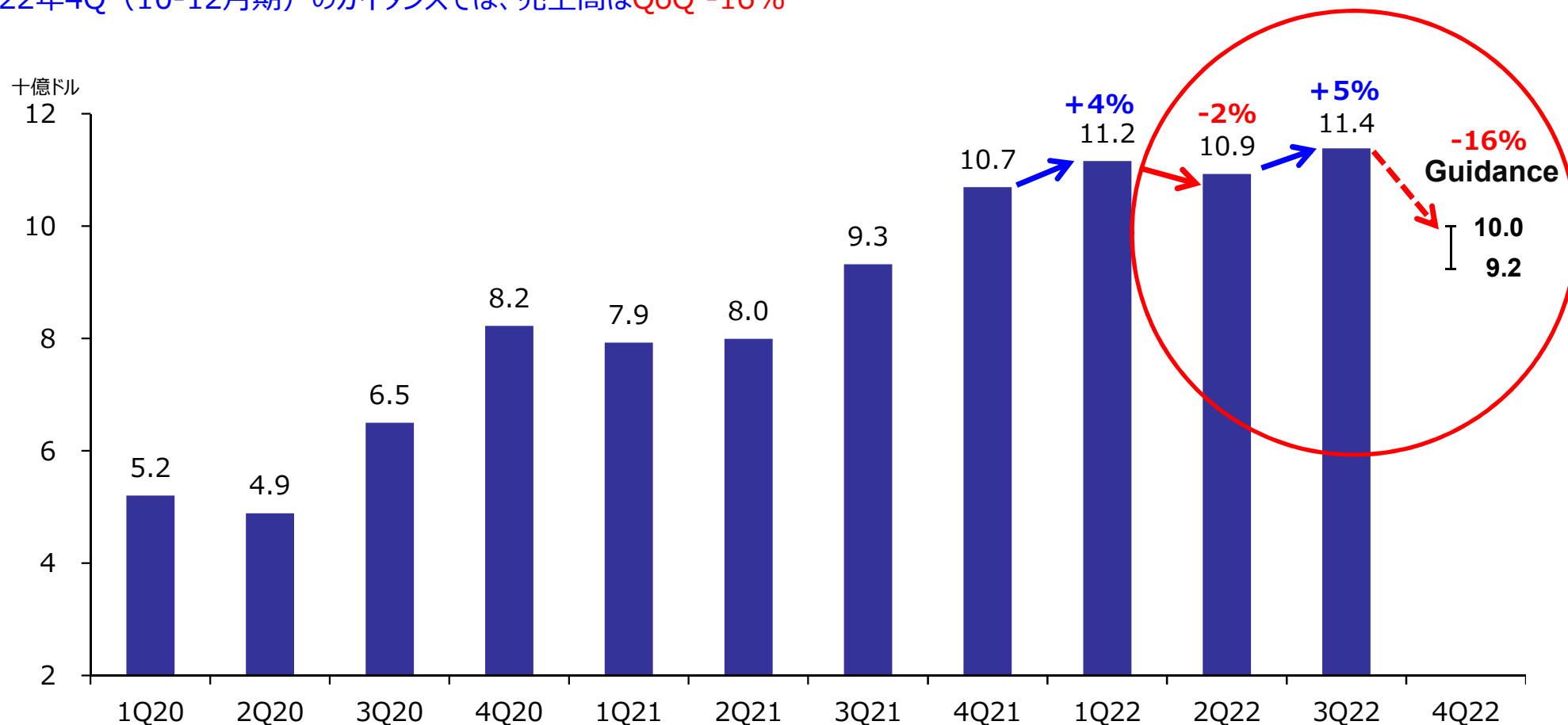


《暦年ベース》

クアルコム 売上高 (2022年4-6月期)

出所：クアルコム公開情報よりフジミ作成

- 22年3Q (7-9月期) の売上高はQoQ+5%
- 22年4Q (10-12月期) のガイダンスでは、売上高はQoQ -16%



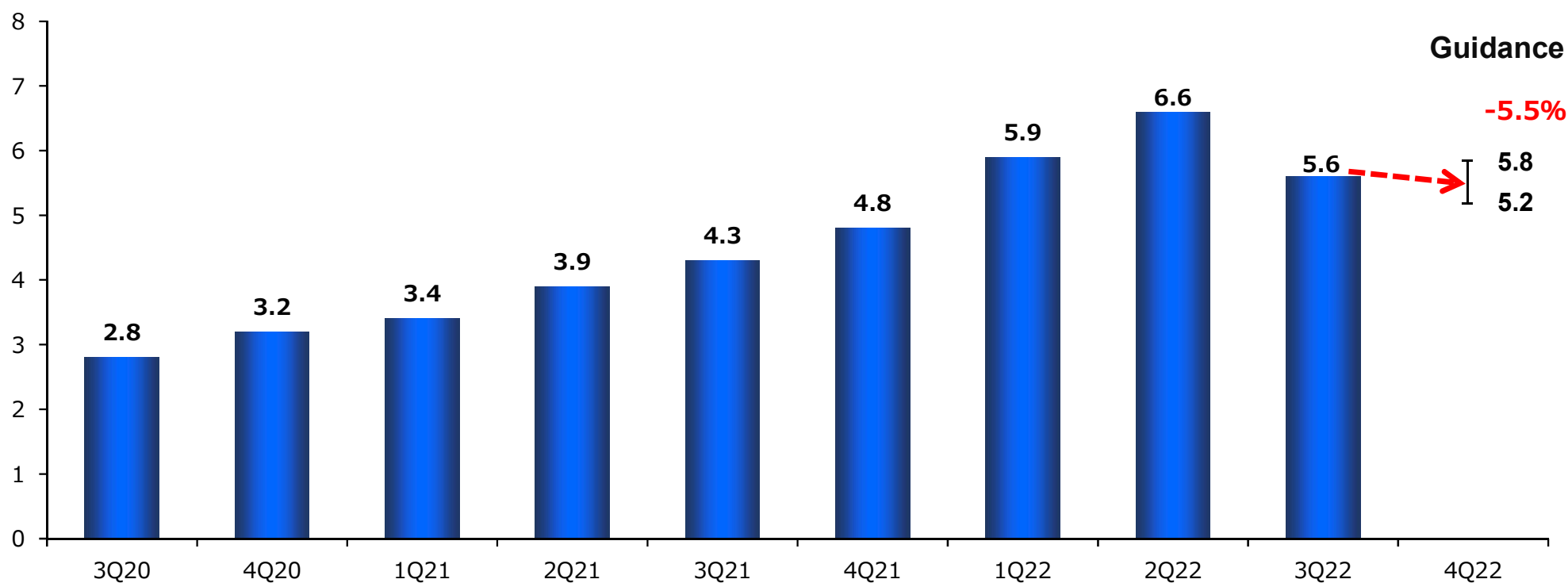
《暦年ベース》

AMD 売上高 (2022年7-9月期)

出所：AMD公開情報よりフジミ作成

- 22年3Q (7-9月期) の売上高はQoQ -16%
- 22年4Q (10-12月期) のガイダンスでは、売上高はQoQ -5.5%
- 減収の主な要因は、PC市場の落ち込みによる需要軟化
- サプライチェーン上にも在庫が積み上がっている

US \$ Billion



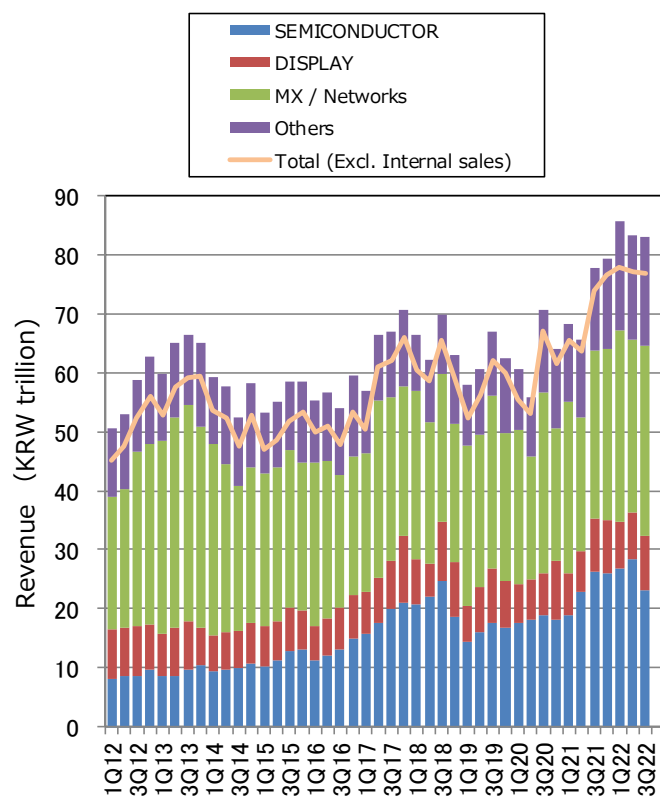
《暦年ベース》

サムスン電子 売上高 (2022年7-9月期)

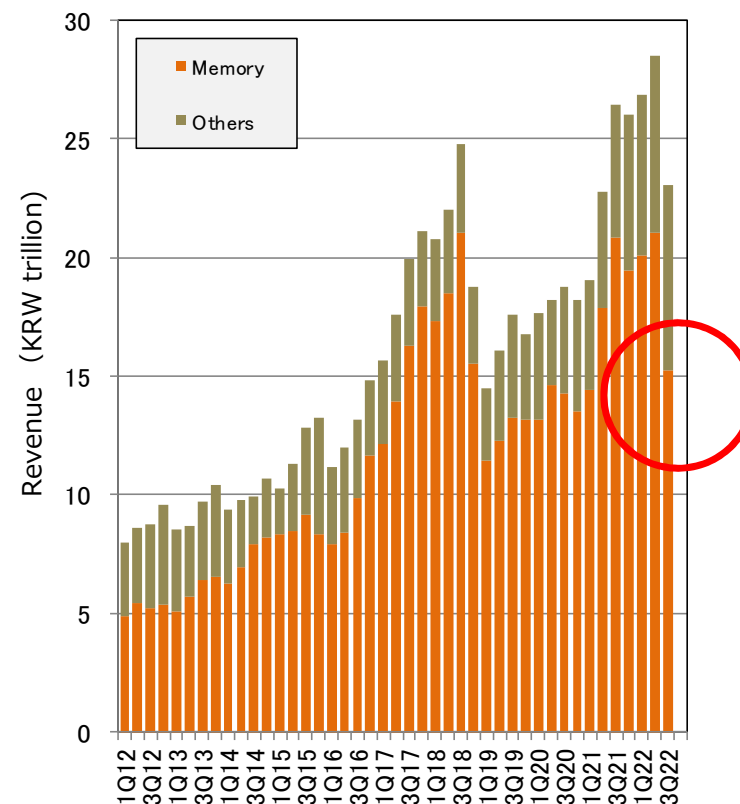
出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

- 半導体事業は、メモリの減速により、22年3Q (7-9月期) 売上高はQoQ -19%

<サムスン電子 全社 売上高>

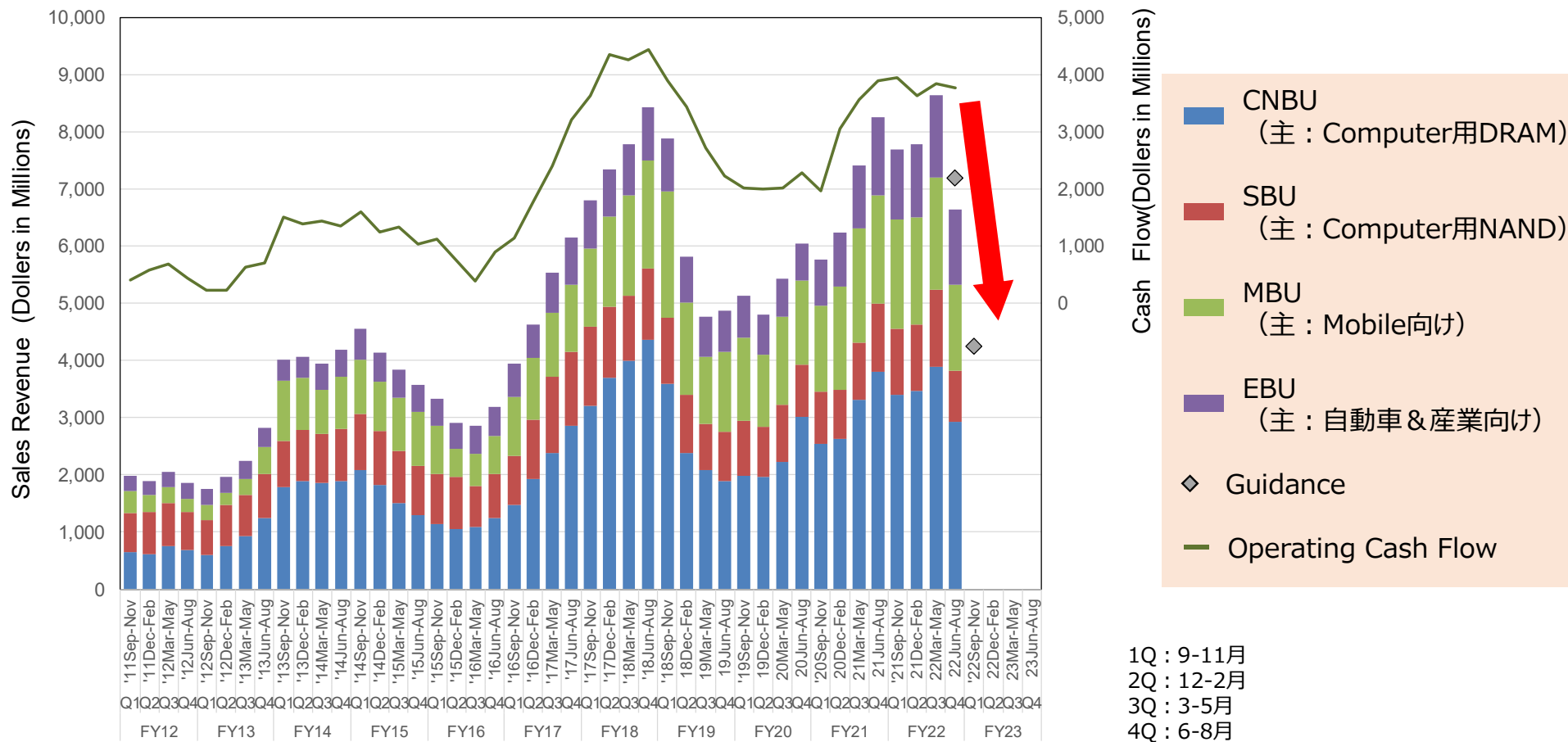


<サムスン電子 半導体事業 売上高>



マイクロン・テクノロジー 売上高 (2022年7-9月期)

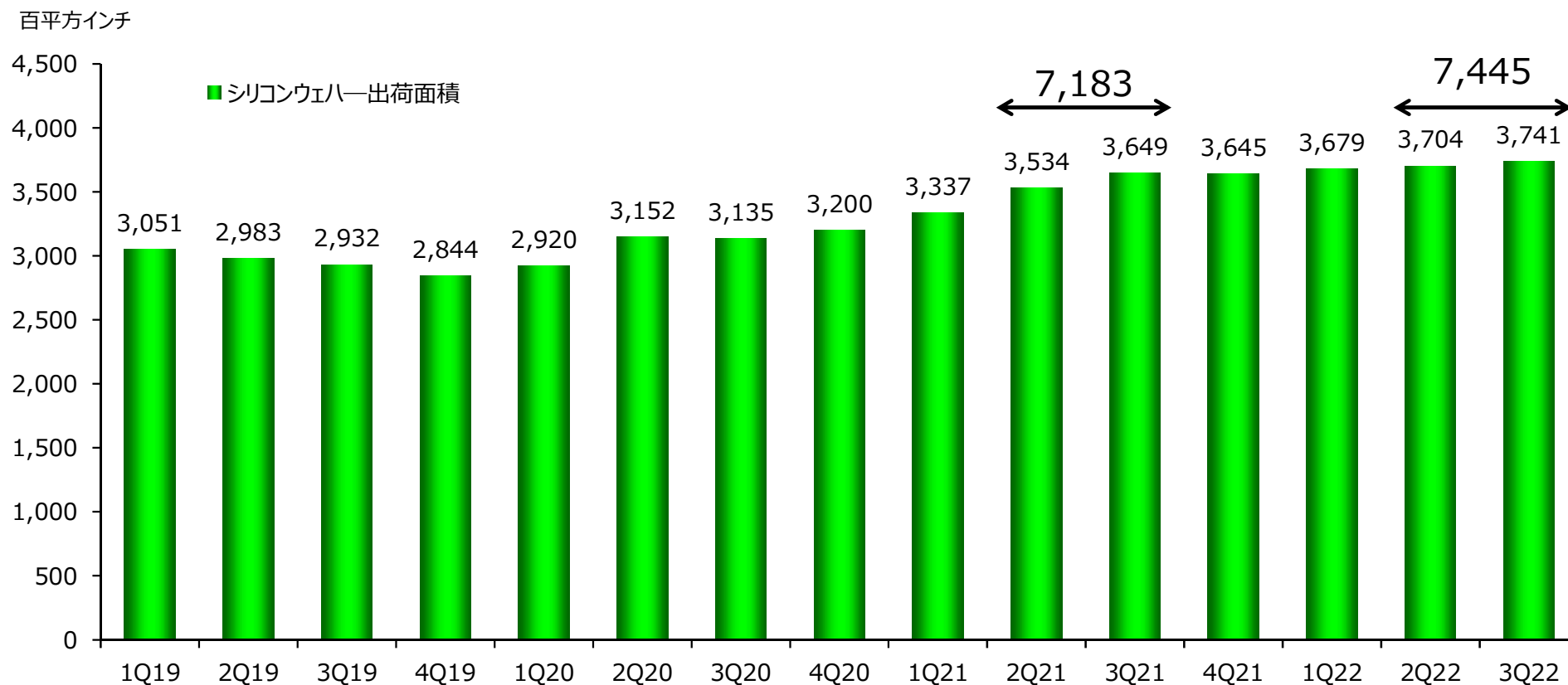
- 22年6-8月期 売上高はQoQ -23%
- 22年9-11月期のガイダンスでは、売上高はQoQ -34%



シリコンウェハー出荷面積 実績 (四半期)

出所：SEMI (2022/10/27)

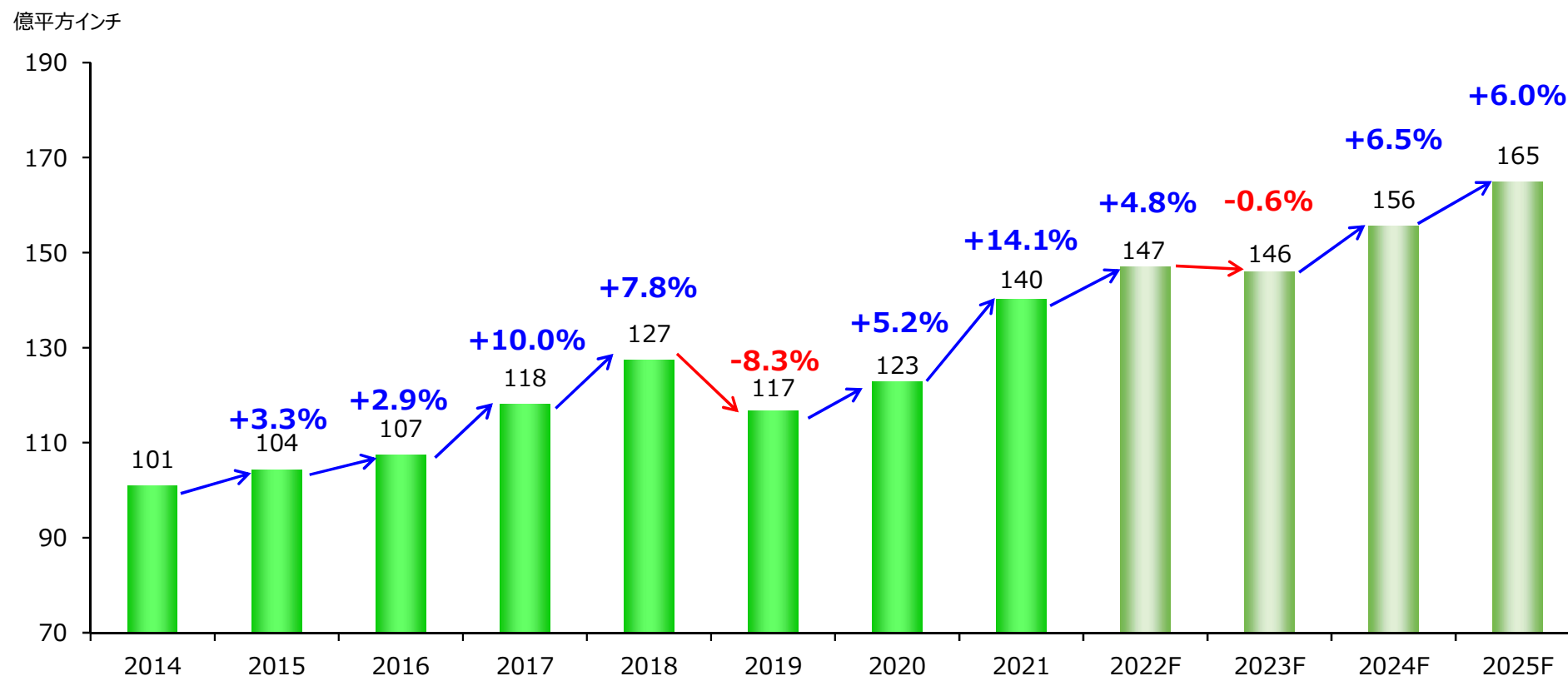
- 2022年4-9月期のシリコンウェハー出荷面積は前年同期比+3.6%



《暦年ベース》

シリコンウェハ需要予測（出荷面積換算 全口径）

- 2022年は+4.8%を見込むも、2023年はマイナス成長予測

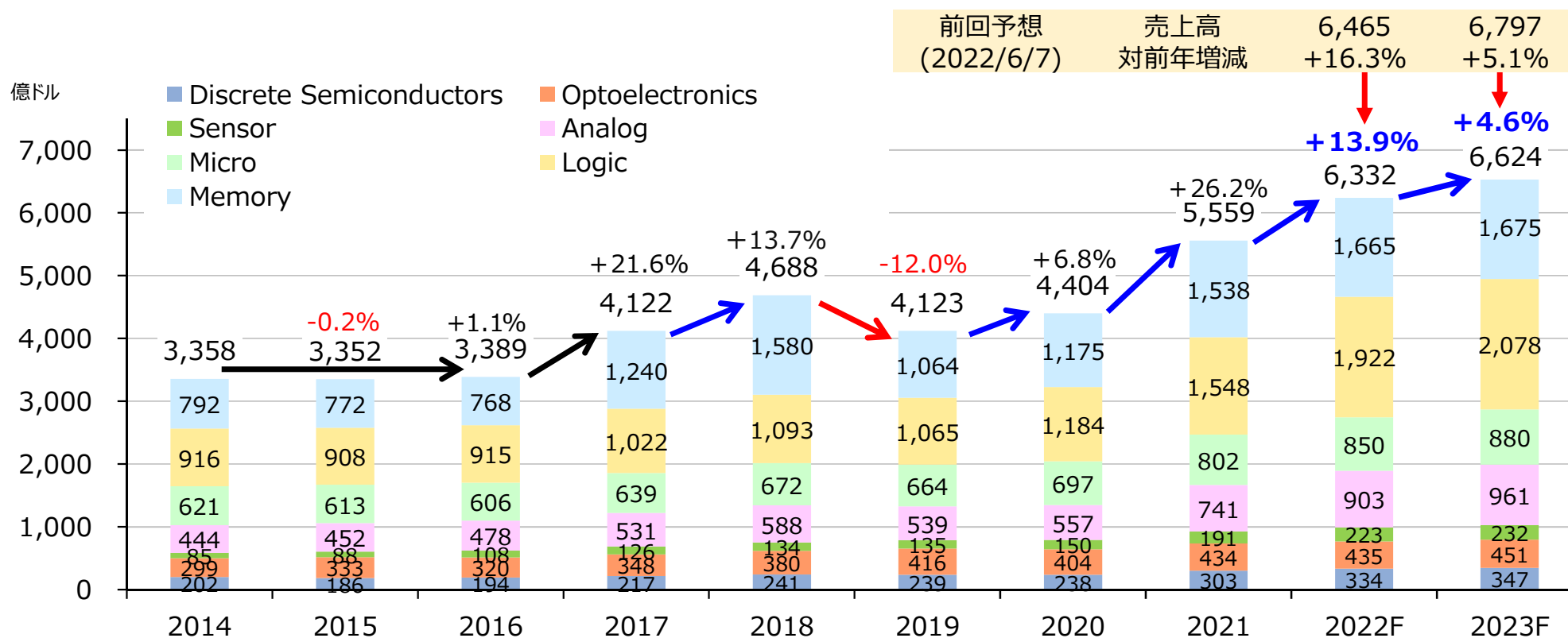


世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2022/8/22）

- 2022年、2023年の市場予想は、世界的な景気後退の懸念により、8月に下方修正
- 2022年の市場予想は、メモリ市場の軟化により、16.3%（前回6月予想）から13.9%へ下方修正
- 2023年の市場予想は、5.1%から4.6%へ下方修正

（ただし、足元の状況を鑑みると、2023年の市場は、かなり厳しくなるものと予想される）



《暦年ベース》

決算概要

決算概要（上期実績）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('22/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/5)
売上高	25,291	26,439	28,500	31,097	+23.0%	+17.6%	+9.1%
営業利益 率	6,158 24.4%	5,900 22.3%	6,500 22.8%	7,819 25.1%	+27.0% -	+32.5% -	+20.3% -
経常利益 率	6,357 25.1%	6,133 23.2%	6,550 23.0%	8,293 26.7%	+30.5% -	+35.2% -	+26.6% -
四半期純利益 率	4,803 19.0%	4,353 16.5%	4,800 16.8%	6,155 19.8%	+28.1% -	+41.4% -	+28.2% -

・前年同期比 大幅増収増益

- ロジック、メモリともに最先端半導体需要好調・一部顧客の在庫積増し（サイバー攻撃後のリカバリー出荷を含む）
- シリコンウェハーも高稼働で推移
- このため、製品構成が良化
- 為替差益による経常利益増

・為替実績 133円/ドル

業績予想（下期予想）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/5)	下期修正予想 ('22/11)	前年同期比	同年上期比	期初予想比 ('22/5)
売上高	25,291	26,439	31,097	29,500	31,103	+17.6%	+0.0%	+5.4%
営業利益 率	6,158 24.4%	5,900 22.3%	7,819 25.1%	7,000 23.7%	6,980 22.4%	+18.3% -	△10.7% -	△0.3% -
経常利益 率	6,357 25.1%	6,133 23.2%	8,293 26.7%	7,050 23.9%	7,006 22.5%	+14.2% -	△15.5% -	△0.6% -
四半期純利益 率	4,803 19.0%	4,353 16.5%	6,155 19.8%	5,200 17.6%	5,344 17.2%	+22.8% -	△13.2% -	+2.8% -

- ・前年同期比では大幅増収増益だが、上期比では売上高横ばいなるも減益
 - 売上高：円安による増収を見込むも、サイバー攻撃後のリカバリー出荷終了、半導体需要の軟化(CMP)、HDD低迷
 - 利益：円安による増益、製品の値上げを見込むも、原材料価格高騰や経費増加により減益
- ・想定為替レート：145円／ドル

業績予想（通期予想）

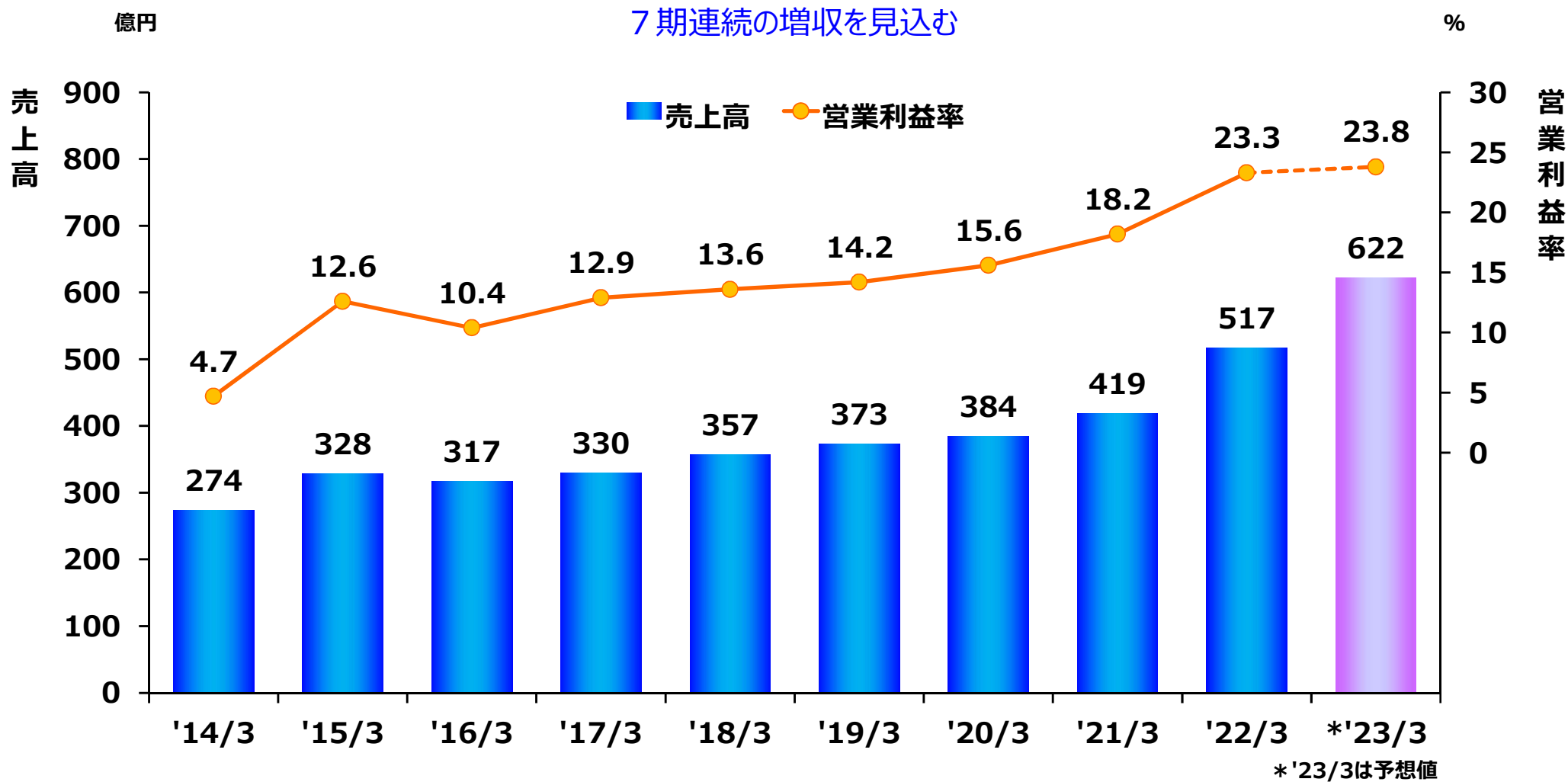
単位：百万円

	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	期初予想 ('22/5)	修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/5)
売上高	51,731	58,000	62,200	+20.2%	+7.2%
営業利益 率	12,059 23.3%	13,500 23.3%	14,800 23.8%	+22.7% -	+9.6% -
経常利益 率	12,490 24.1%	13,600 23.4%	15,300 24.6%	+22.5% -	+12.5% -
当期純利益 率	9,156 17.7%	10,000 17.2%	11,500 18.5%	+25.6% -	+15.0% -

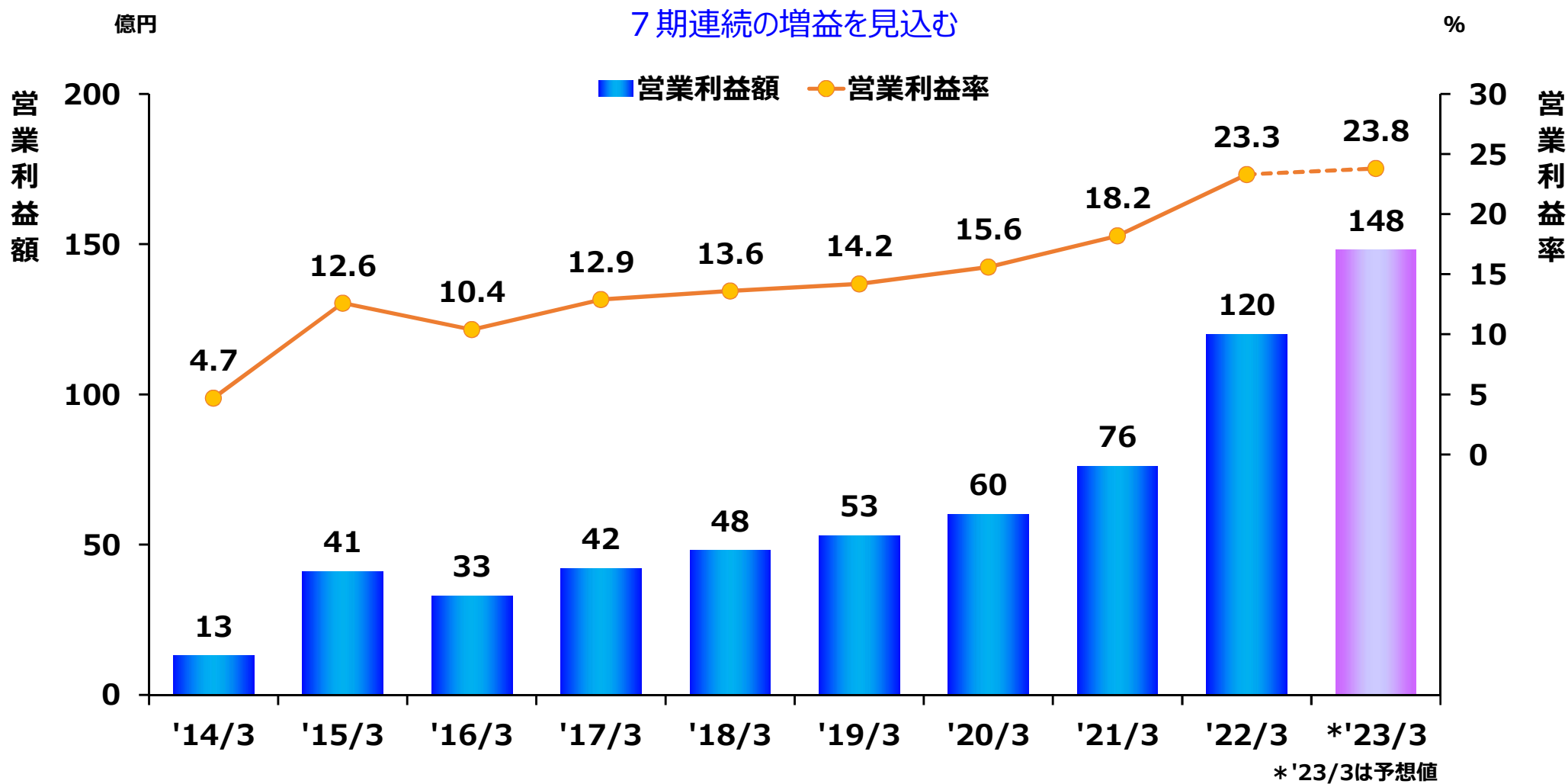
・増収増益予想（売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに、過去最高の更新を見込む）

- シリコン売上高：前期比+17.9%予想
- CMP売上高：前期比+26.2%予想

業績推移 (今期予想含む)



営業利益（今期予想含む）



用途別売上高

用途別売上高（上期実績）

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウエハー	ラッピング	2,985	3,264	3,550	3,538	+18.5%	+8.4%	△0.3%
	ポリシング	6,007	6,142	7,020	7,013	+16.7%	+14.2%	△0.1%
	切断	136	129	130	109	△19.5%	△15.4%	△15.5%
	計	9,129	9,536	10,700	10,661	+16.8%	+11.8%	△0.4%
CMP		12,155	12,416	13,400	15,771	+29.8%	+27.0%	+17.7%
ディスク	アルミディスク	770	913	965	987	+28.1%	+8.1%	+2.3%
	ガラスディスク	19	21	15	14	△25.0%	△30.0%	△0.2%
	計	790	935	980	1,002	+26.8%	+7.2%	+2.3%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,310	2,338	+9.2%	+3.1%	+1.2%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,050	1,252	+29.3%	+2.3%	+19.3%
	計	3,109	3,491	3,360	3,590	+15.5%	+2.8%	+6.9%
製品売上高		25,185	26,379	28,440	31,026	+23.2%	+17.6%	+9.1%
商品売上高		106	60	60	70	△33.8%	+17.0%	+1.0%
売上高 合計		25,291	26,439	28,500	31,097	+23.0%	+17.6%	+9.1%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

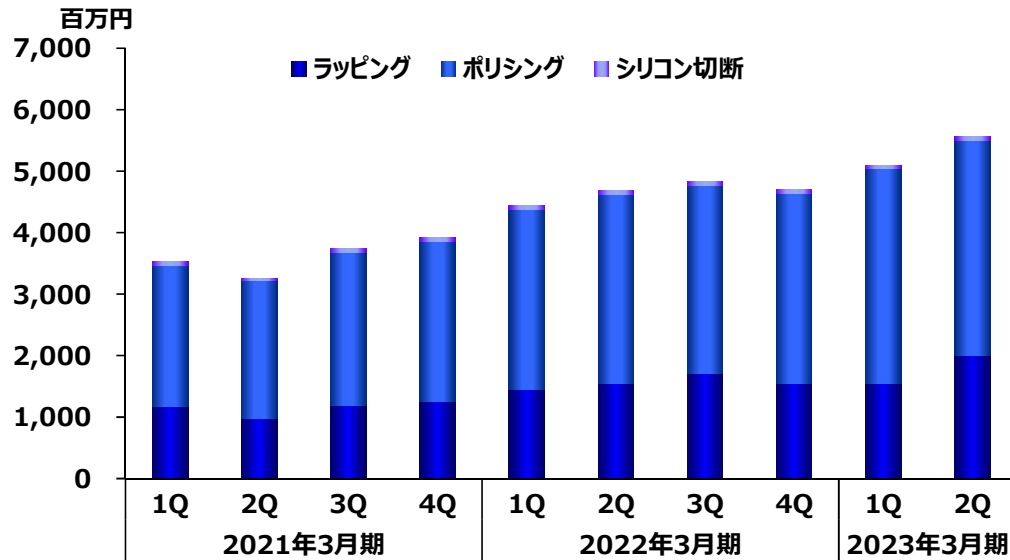
		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期 修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウエハー	ラッピング	4,604	6,249	7,190	7,421	+18.7%	+3.2%
	ポリシング	9,621	12,149	14,100	14,144	+16.4%	+0.3%
	切断	245	266	260	233	△12.5%	△10.4%
	計	14,472	18,665	21,550	21,800	+16.8%	+1.2%
CMP		20,037	24,571	27,400	31,000	+26.2%	+13.1%
ディスク	アルミディスク	1,668	1,684	1,945	1,650	△2.1%	△15.2%
	ガラスディスク	36	41	55	50	+20.9%	△9.1%
	計	1,705	1,725	2,000	1,700	△1.5%	△15.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,779	4,408	4,730	5,000	+13.4%	+5.7%
	一般工業用(非研磨材)	1,909	2,192	2,200	2,600	+18.6%	+18.2%
	計	5,688	6,600	6,930	7,600	+15.1%	+9.7%
製品売上高		41,903	51,564	57,880	62,100	+20.4%	+7.3%
商品売上高		52	167	120	100	△40.2%	△16.7%
売上高 合計		41,956	51,731	58,000	62,200	+20.2%	+7.2%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハー	ラッピング	2,985	3,264	3,550	3,538	+18.5%	+8.4%	△0.3%
	ポリシング	6,007	6,142	7,020	7,013	+16.7%	+14.2%	△0.1%
	切断	136	129	130	109	△19.5%	△15.4%	△15.5%
	計	9,129	9,536	10,700	10,661	+16.8%	+11.8%	△0.4%



・ 事業環境

- 半導体業界の高い稼働に支えられシリコンウェハー市場は堅調
- シリコンウェハーの出荷面積も上期は過去最高を更新

・ ラッピング、ポリシング製品の増収要因

- 上記要因による堅調な需要
- 原材料価格高騰に伴う売価アップ（ラッピング製品）
- 1・2 研におけるシェアアップ継続（ポリシング製品）

シリコンウェハ―売上高（下期予想・通期予想）

・シリコンウェハ―の高稼働の継続、ラッピングの原材料価格高騰に伴う売価アップ

《下期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハ―	ラッピング	2,985	3,264	3,538	3,640	3,883	+19.0%	+9.7%	+6.7%
	ポリシング	6,007	6,142	7,013	7,080	7,132	+16.1%	+1.7%	+0.7%
	切断	136	129	109	130	123	△5.3%	+11.9%	△5.4%
	計	9,129	9,536	10,661	10,850	11,140	+16.8%	+4.5%	+2.7%

《通期》

単位：百万円

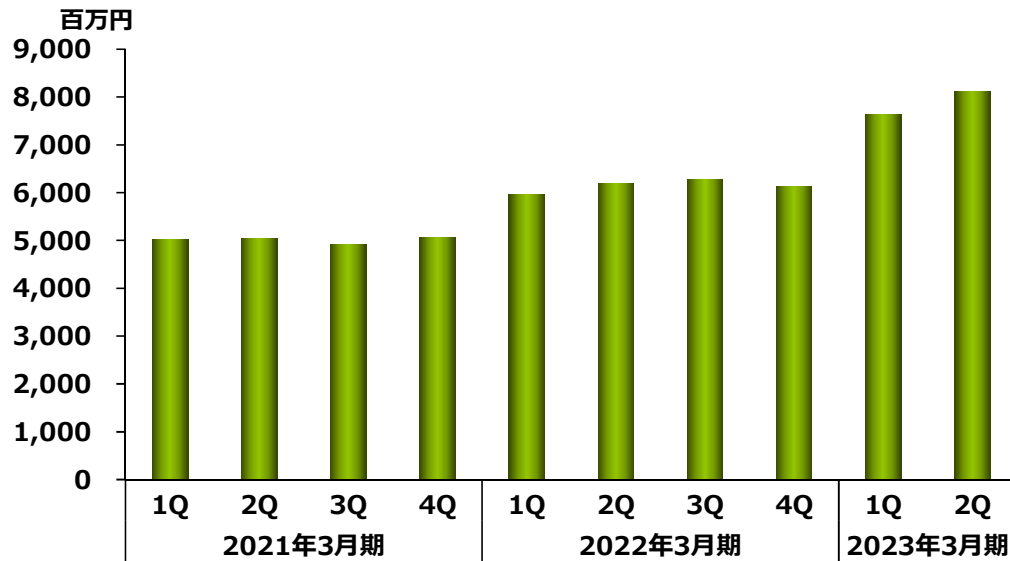
		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハ―	ラッピング	4,604	6,249	7,190	7,421	+18.7%	+3.2%
	ポリシング	9,621	12,149	14,100	14,144	+16.4%	+0.3%
	切断	245	266	260	233	△12.5%	△10.4%
	計	14,472	18,665	21,550	21,800	+16.8%	+1.2%

CMP売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
CMP	12,155	12,416	13,400	15,771	+29.8%	+27.0%	+17.7%



・ 事業環境

- PC及びスマートフォン市場の落ち込みに伴いロジック、メモリデバイスともに需要は軟化、在庫も増加
- 一方で、先端半導体デバイスでは高い稼働が継続

・ CMP向け製品の増収要因

- ロジック、メモリともに最先端半導体需要好調（一部顧客での在庫積み増し・サイバー攻撃後のリカバリー出荷もあり）
- 原材料価格高騰に伴う売価アップ
- 為替の影響

CMP売上高（下期予想・通期予想）

・ ロジック、メモリともに半導体需要の軟化を想定

「下期」

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
CMP	12,155	12,416	15,771	14,000	15,229	+22.7%	△3.4%	+8.8%

「通期」

単位：百万円

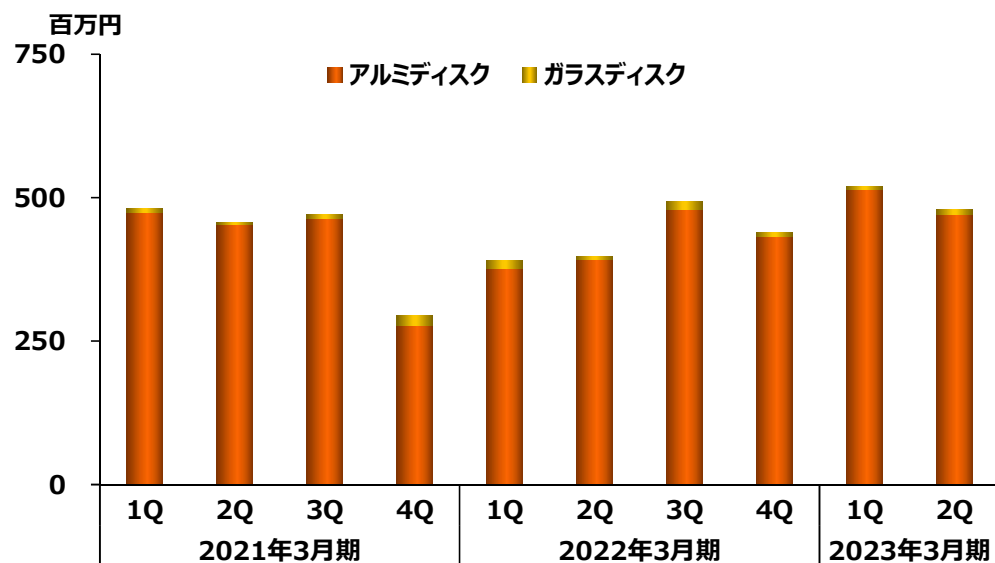
	21年3月期	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
CMP	20,037	24,571	27,400	31,000	+26.2%	+13.1%

ディスク売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
ディスク	アルミディスク	770	913	965	987	+28.1%	+8.1%	+2.3%
	ガラスディスク	19	21	15	14	△25.0%	△30.0%	△0.2%
	計	790	935	980	1,002	+26.8%	+7.2%	+2.3%



- ・ 事業環境
HDDからSSDへの移行
- ・ アルミディスク向け製品の増収要因
 - 当社顧客の稼働回復
 - 為替の影響

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

・ HDD市況低迷による需要減を想定

「下期」

単位：百万円

		22年3月期		22年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
ディスク	アルミディスク	770	913	987	980	663	△27.4%	△32.9%	△32.3%
	ガラスディスク	19	21	14	40	35	+63.7%	+133.8%	△12.5%
	計	790	935	1,002	1,020	698	△25.4%	△30.4%	△31.6%

「通期」

単位：百万円

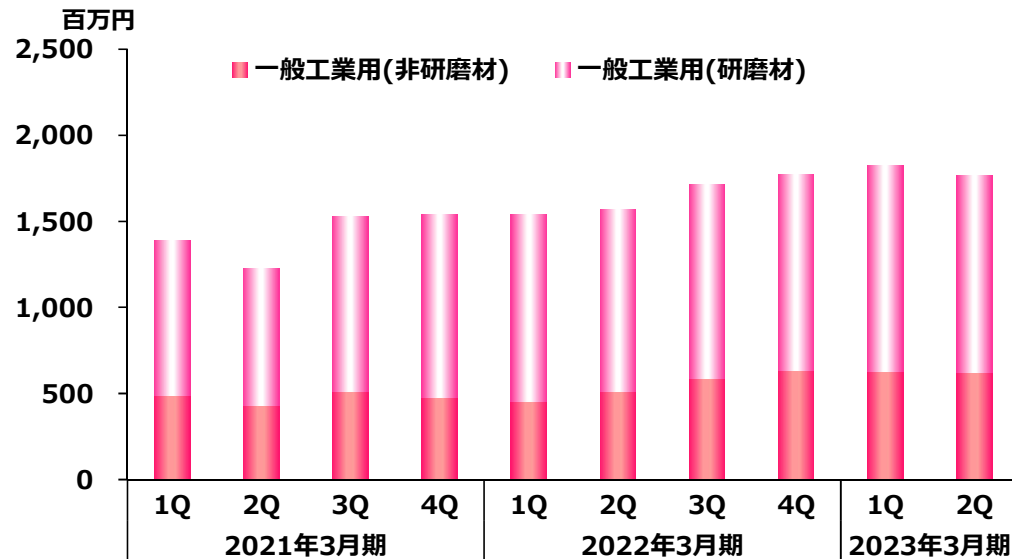
		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
ディスク	アルミディスク	1,668	1,684	1,945	1,650	△2.1%	△15.2%
	ガラスディスク	36	41	55	50	+20.9%	△9.1%
	計	1,705	1,725	2,000	1,700	△1.5%	△15.0%

機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,310	2,338	+9.2%	+3.1%	+1.2%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,050	1,252	+29.3%	+2.3%	+19.3%
	計	3,109	3,491	3,360	3,590	+15.5%	+2.8%	+6.9%



- ・ 上期の事業環境
 - 自動車及び産業機械向け需要の回復
 - 半導体製造装置の旺盛な投資
- ・ 一般工業用（研磨材）の増収要因
 - 上記要因により需要増加
- ・ 一般工業用（非研磨材）
 - 上記要因により需要増加

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

・ SiCウェハー向け研磨材の販売増を想定（マレーシア拠点で生産予定）

「下期」

単位：百万円

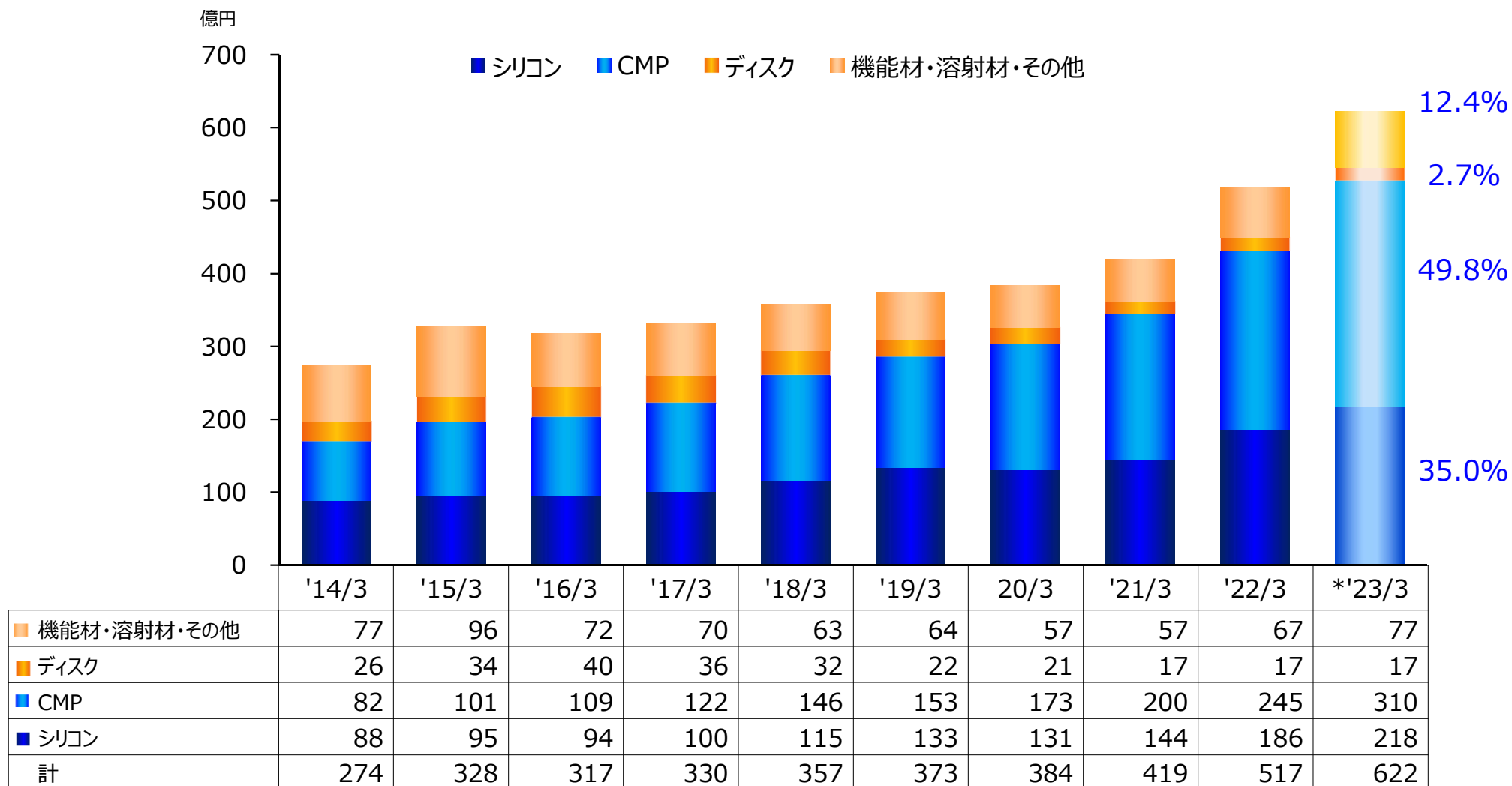
		22年3月期		23年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,338	2,420	2,662	+17.4%	+13.8%	+10.0%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,252	1,150	1,346	+10.0%	+7.5%	+17.0%
	計	3,109	3,491	3,590	3,570	4,008	+14.8%	+11.6%	+12.3%

「通期」

単位：百万円

		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,779	4,408	4,730	5,000	+13.4%	+5.7%
	一般工業用(非研磨材)	1,909	2,192	2,200	2,600	+18.6%	+18.2%
	計	5,688	6,600	6,930	7,600	+15.1%	+9.7%

用途別売上高（通期）



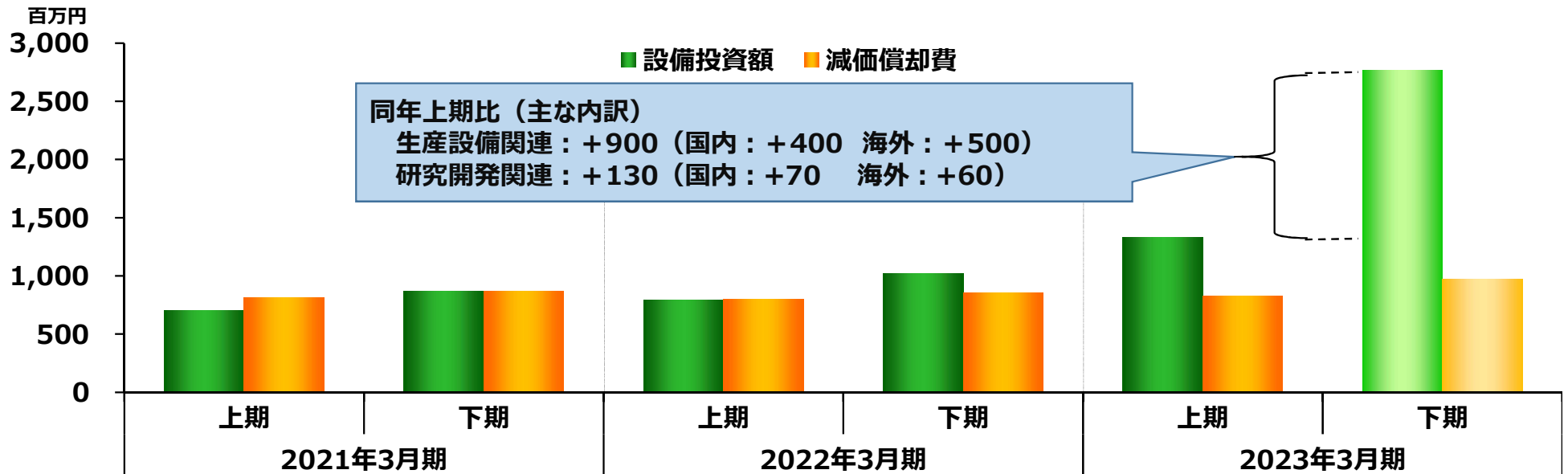
設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('22/6)	下期計画 ('22/6)	下期修正計画 ('22/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 ('22/6)
設備投資額	789	1,024	1,800	1,333	+68.9%	+30.1%	△25.9%	1,600	2,766	+170.0%	+107.5%	+72.9%
減価償却費	802	859	850	826	+3.0%	△3.8%	△2.8%	950	973	+13.3%	+17.8%	+2.5%

* 設備投資額は検収基準



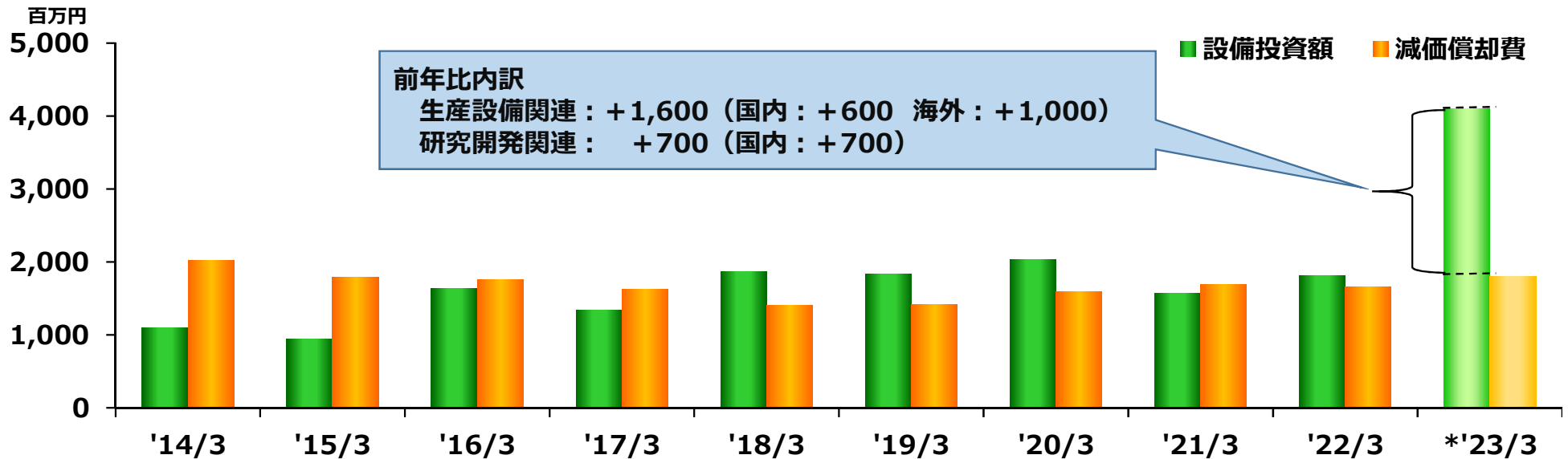
* '23/3下期は計画

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	通期計画 ('22/6)	通期修正計画 ('22/11)	前期比	期初計画比 ('22/6)
設備投資	1,814	3,400	4,100	+126.0%	+20.6%
減価償却費	1,661	1,800	1,800	+8.3%	0.0%

* 設備投資額は検収基準

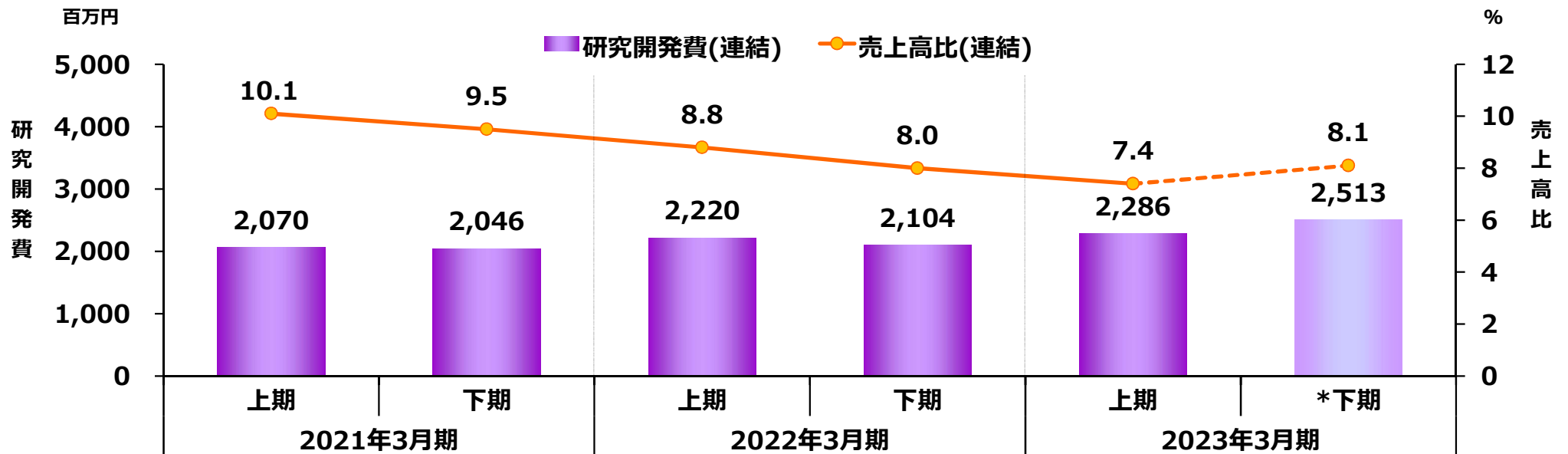


*'23/3は計画

研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('22/6)	上期実績			下期計画 ('22/6)	下期修正計画 ('22/11)				
				前年同期比	前年下期比	計画比 ('22/6)		前年同期比	同年上期比	計画比 ('22/6)		
研究開発費	2,220	2,104	2,400	2,286	+3.0%	+8.7%	△4.7%	2,400	2,513	+19.4%	+9.9%	+4.7%

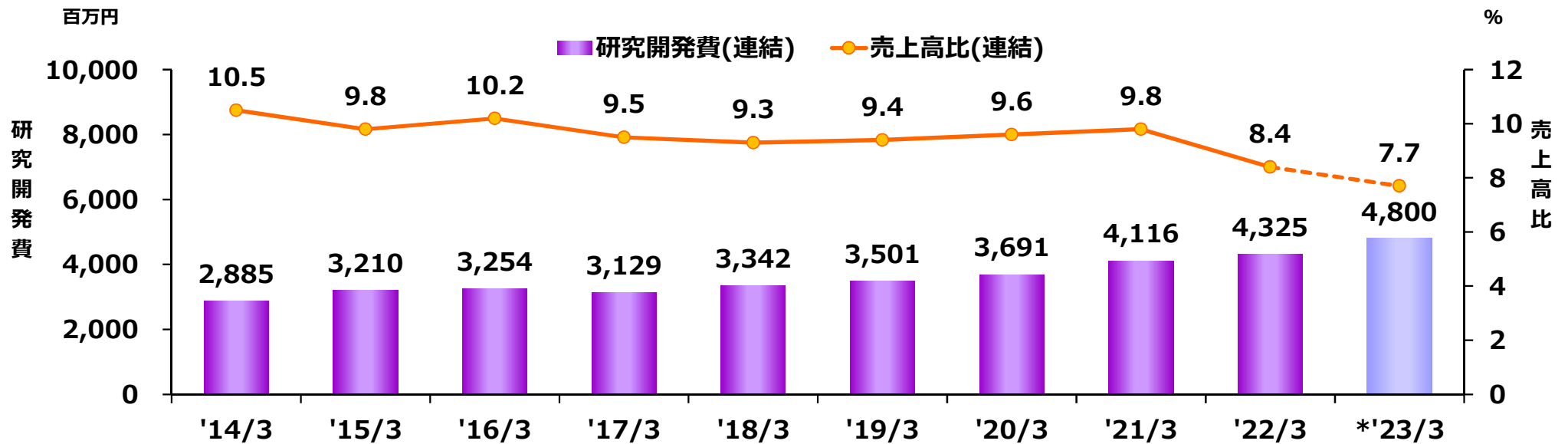


* '23/3下期は計画

研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	通期計画 ('22/6)	通期修正計画 ('22/11)	前期比	期初計画比 ('22/6)
研究開発費	4,325	4,800	4,800	+11.0%	0.0%



*'23/3は計画

損益分析

営業利益増減要因 22/3期上期実績 → 23/3期上期実績

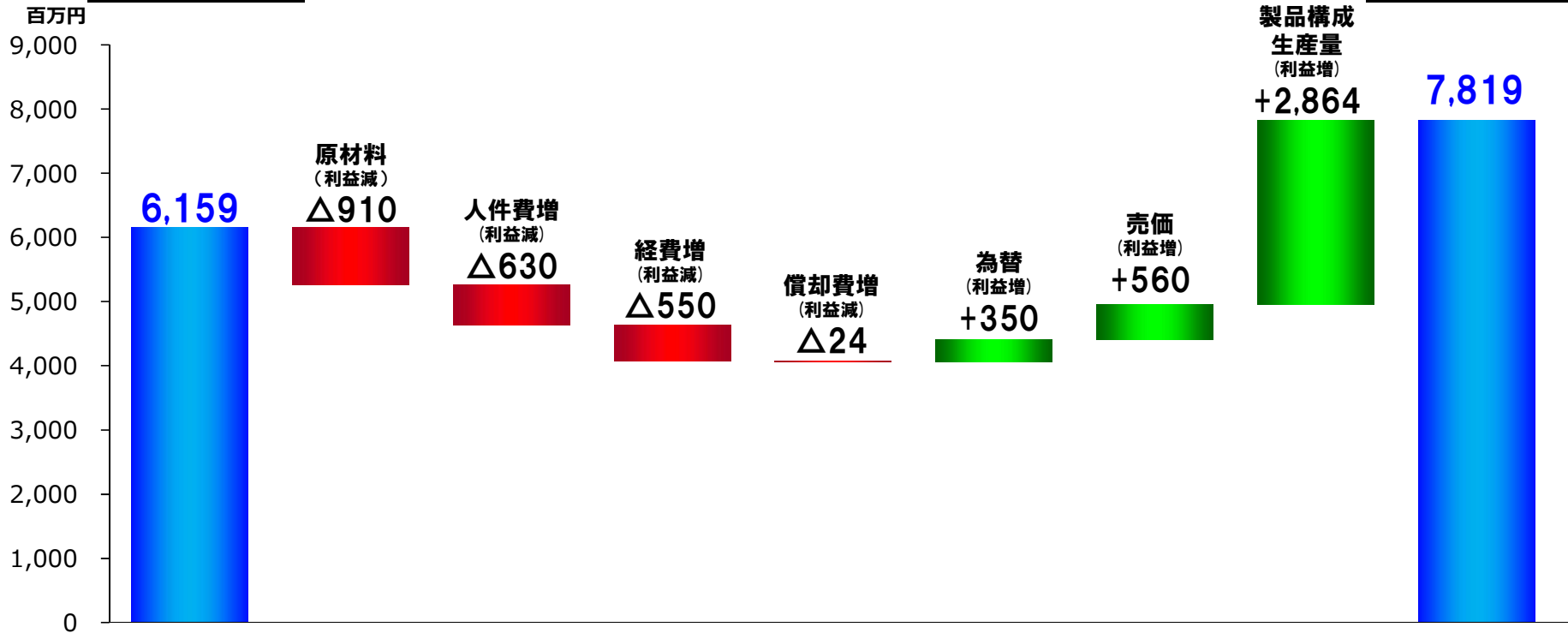
売上高 253億円

311億円

22/3期
上期実績

(売上増) +5,809百万円
(利益増) +1,660百万円

23/3期
上期実績



営業利益増減要因 23/3期上期実績 → 23/3期下期予想

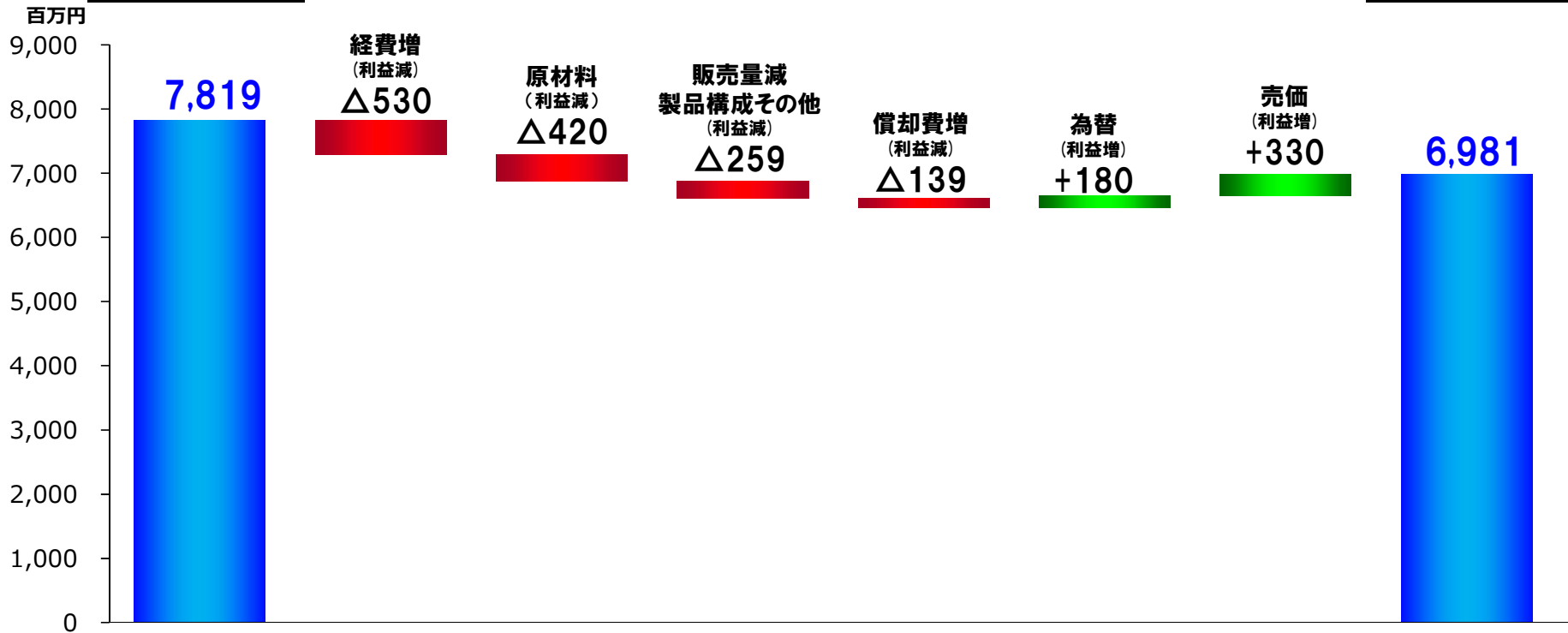
売上高 311億円

311億円

23/3期
上期実績

(売上増) +6百万円
(利益減) △838百万円

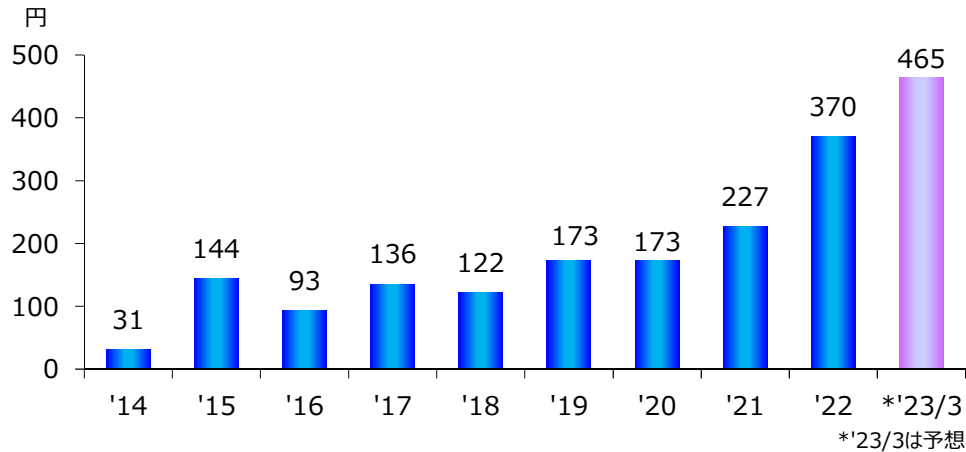
23/3期
下期予想



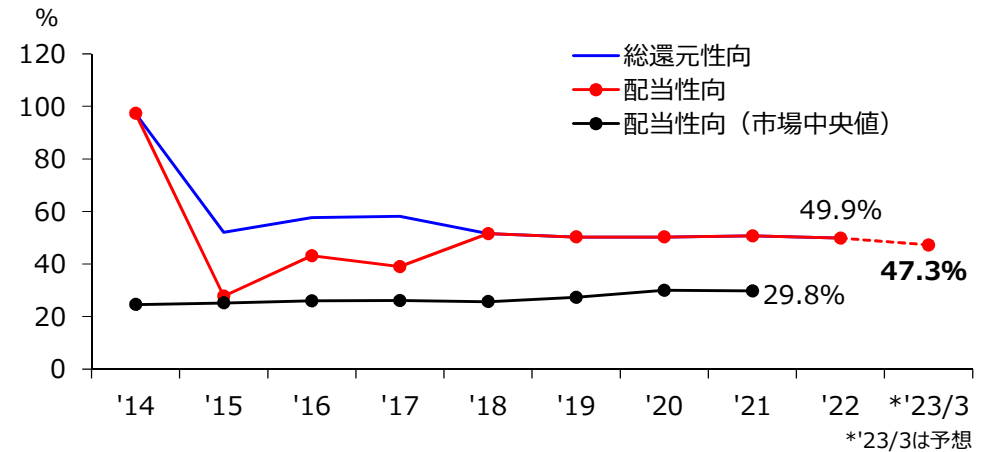
株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

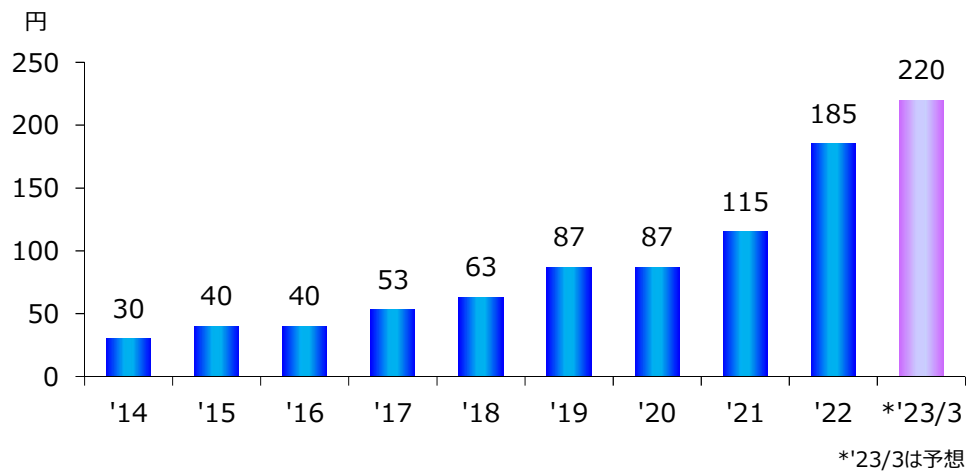
1株当たり当期純利益



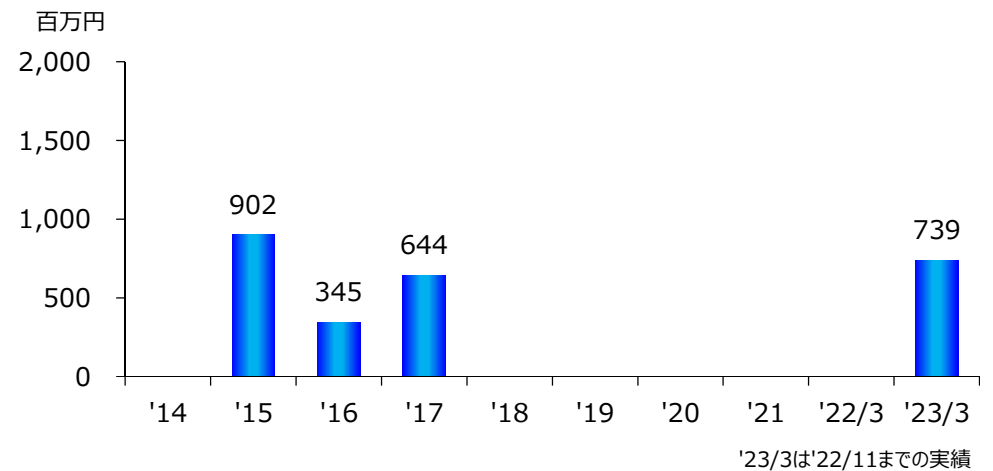
総還元性向・配当性向



1株当たり配当金



自己株買い



2023年3月期 上期業績サマリー／通期業績予想

【2023年3月期 上期業績】 *前年同期比

✓ 売上高	+23.0%*	: 最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売が好調 上期過去最高を更新
✓ 営業利益	+27.0%	: 最先端半導体関連製品の売上増加に加え、製品構成が良化
✓ 経常利益	+30.5%	: 為替円安
✓ 四半期純利益	+28.1%	: 営業利益、経常利益、四半期純利益ともに上期過去最高を更新
✓ シリコンウェハー向け	+16.8%	: 半導体業界の高稼働によりラッピング・ポリシングは増収
✓ CMP向け	+29.8%	: 半導体需要は軟化し在庫が増加するも、ロジック・メモリともに先端向け製品の販売増加
✓ ハードディスク向け	+26.8%	: HDDからSSDへの移行が進むも当社顧客の稼働回復に加え為替の影響もあり増収
✓ 一般工業用向け	+9.2%	: 自動車及び産業機械向け需要の回復もあり増収
✓ 株主還元		: 業績の上振れに伴い、1株当たり配当額を期初予想95円から110円に増配（前年同期85円）

【2023年3月期 通期業績予想】 *前年比

✓ 売上高	+20.2%	: 売上高は2期連続となる過去最高を見込む
✓ 営業利益	+22.7%	: 営業利益・経常利益ともに4期連続となる過去最高を見込む
✓ 経常利益	+22.5%	: 為替円安
✓ 当期純利益	+25.6%	: 当期純利益は5期連続となる過去最高を見込む

補足資料

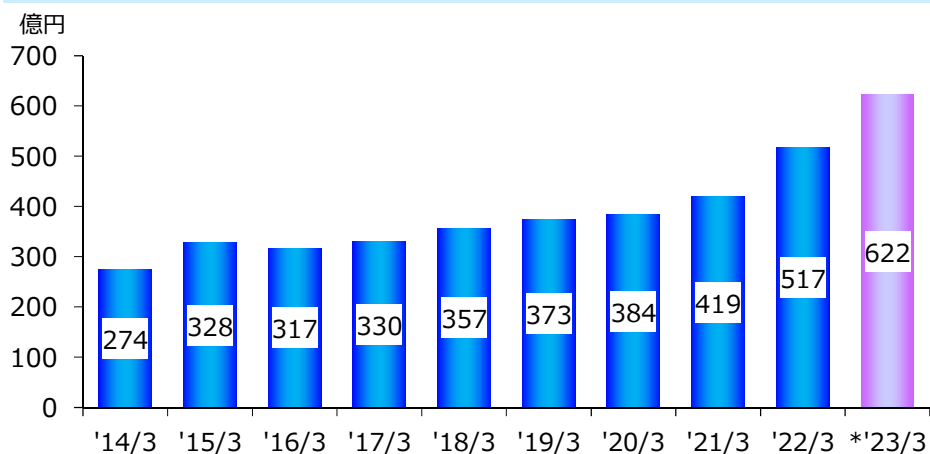
グループ人員 内訳

(人数)	22年3月期 (3月31日現在)		23年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 *	正社員	臨時 雇用者 *	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	693	216	720	205	+27	△11
フジミコーポレーション	118	3	129	2	+11	△1
フジミ台湾	95	2	94	2	△1	—
フジミマイクロテクノロジー	67	5	67	5	—	—
フジミヨーロッパ	4	2	4	2	—	—
フジミ韓国	0	0	0	0	—	—
フジミ深圳	3	1	2	1	△1	—
合 計	980	229	1,016	217	+36	△12

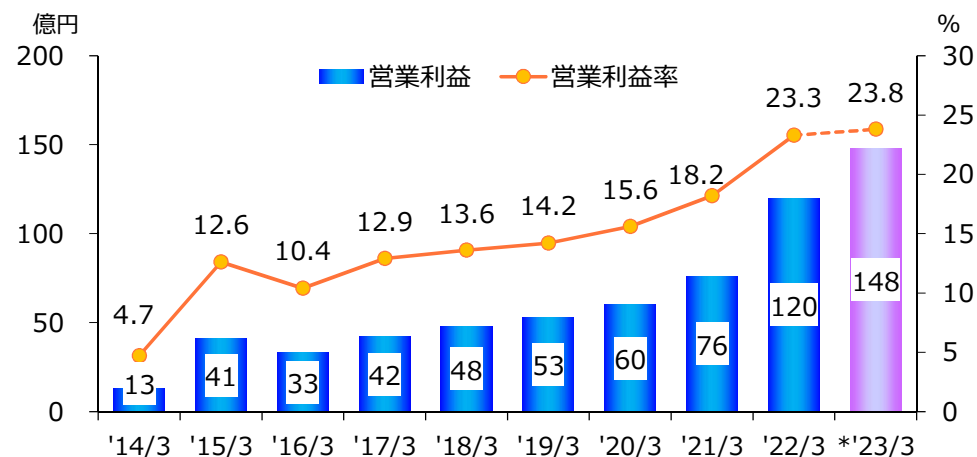
・* 臨時雇用者（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員

業績推移 (通期)

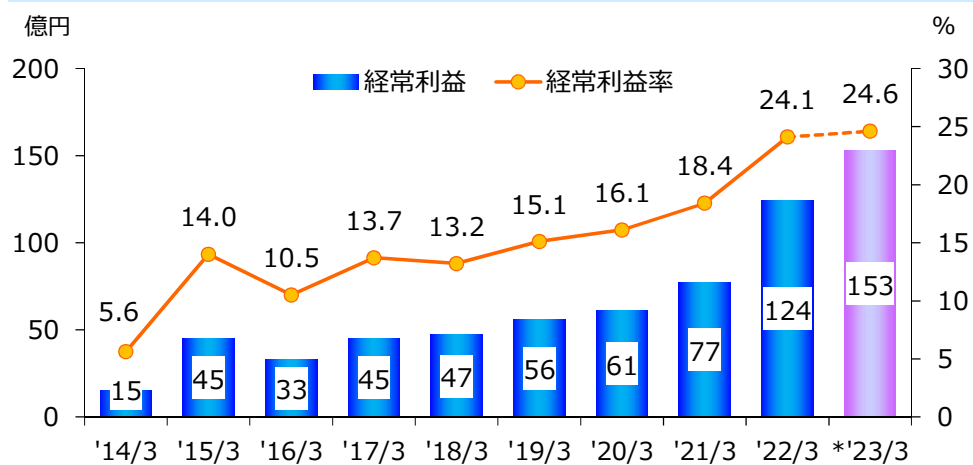
売上高



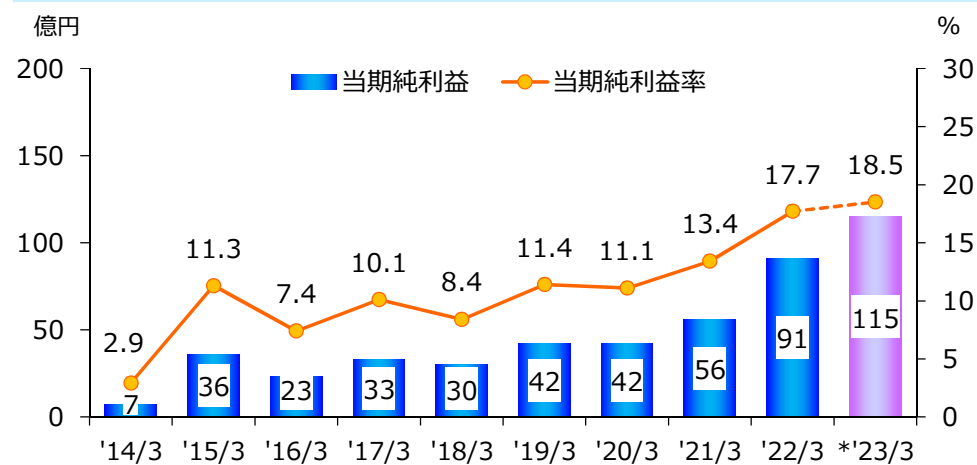
営業利益



経常利益



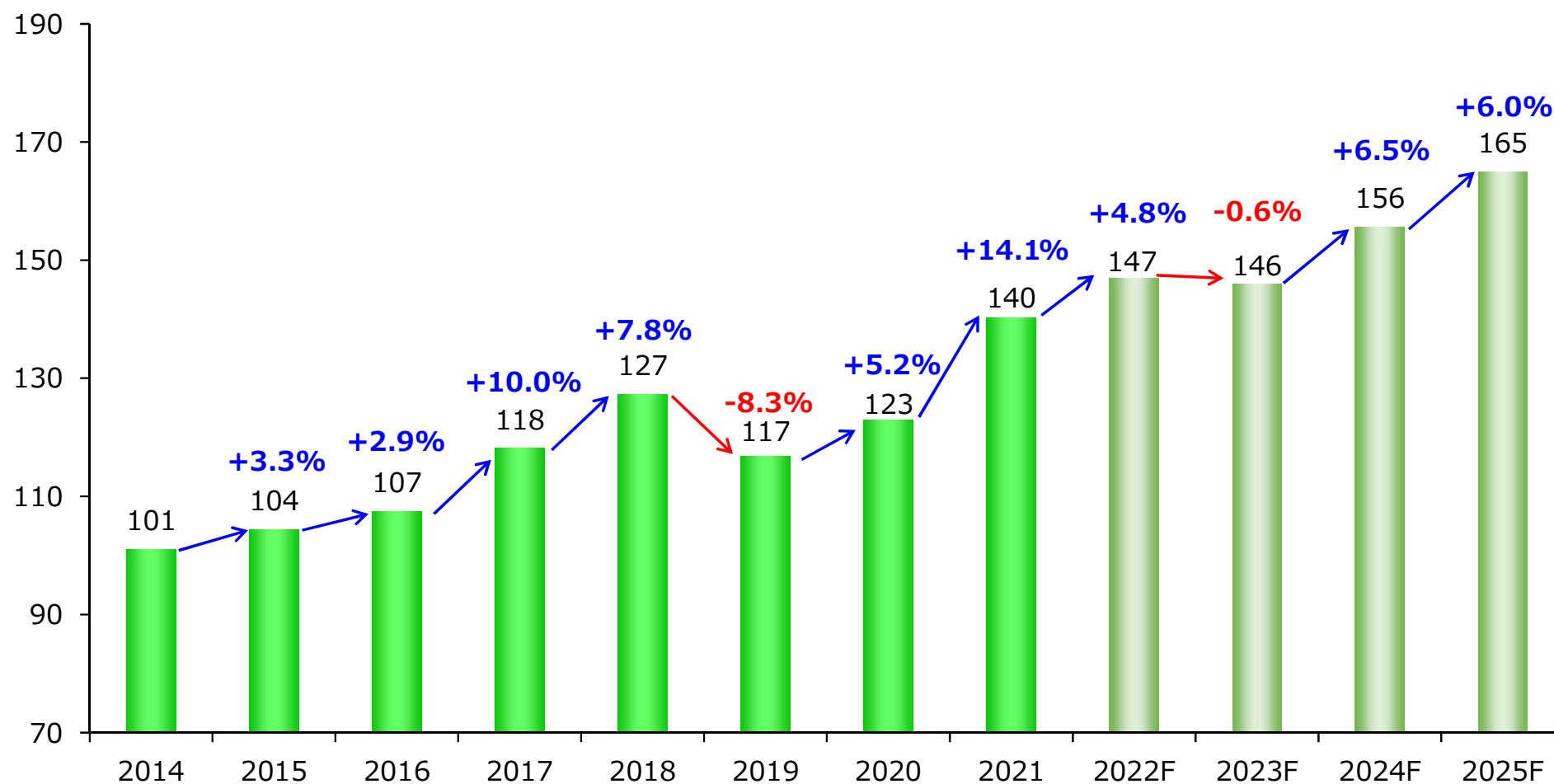
当期純利益



*'23/3は予想値

シリコンウェハ需要予測（出荷面積換算 全口径）

億平方インチ

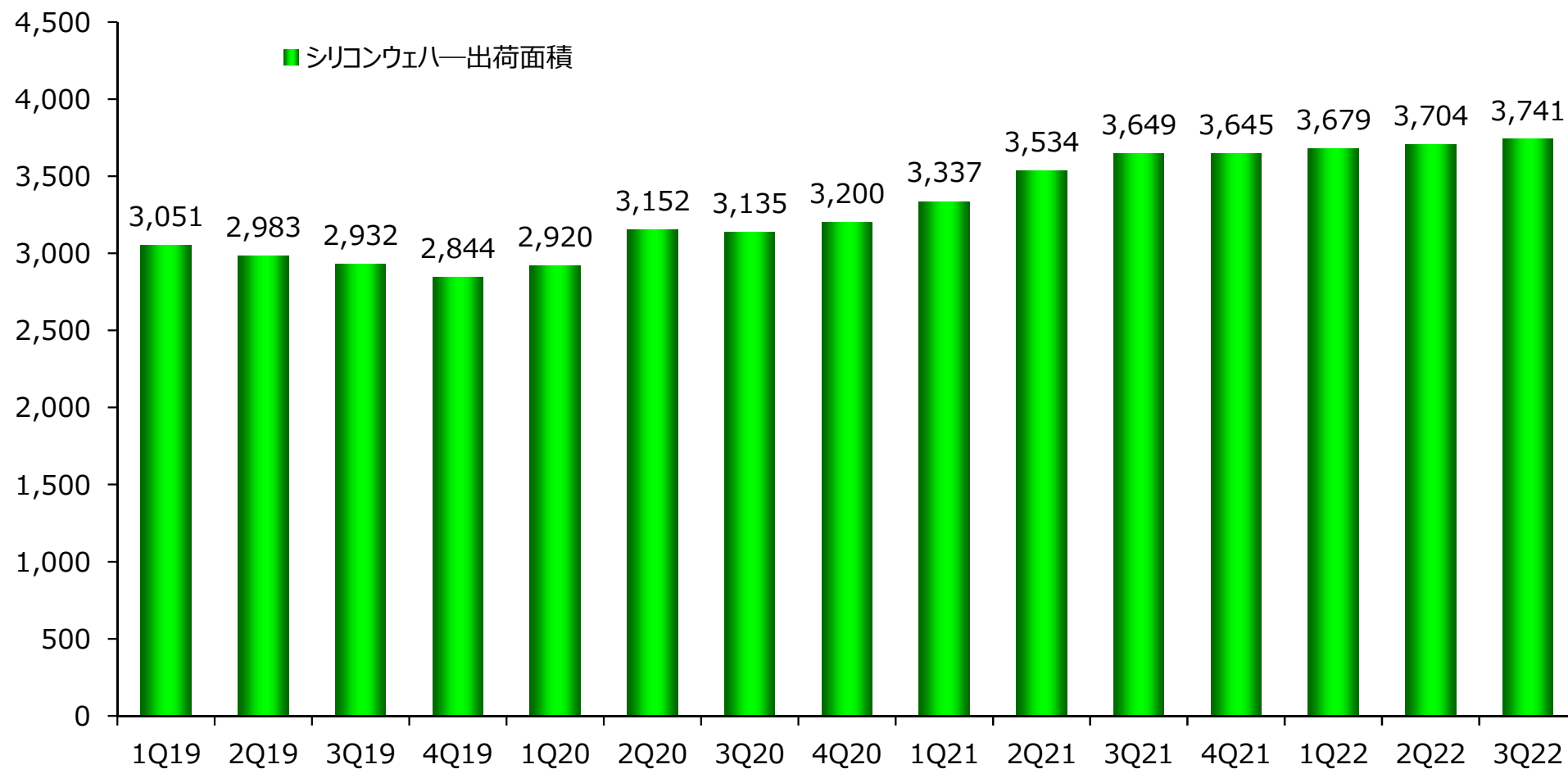


《暦年ベース》

シリコンウェハー出荷面積（四半期）

出所： SEMI (2022/10/27)

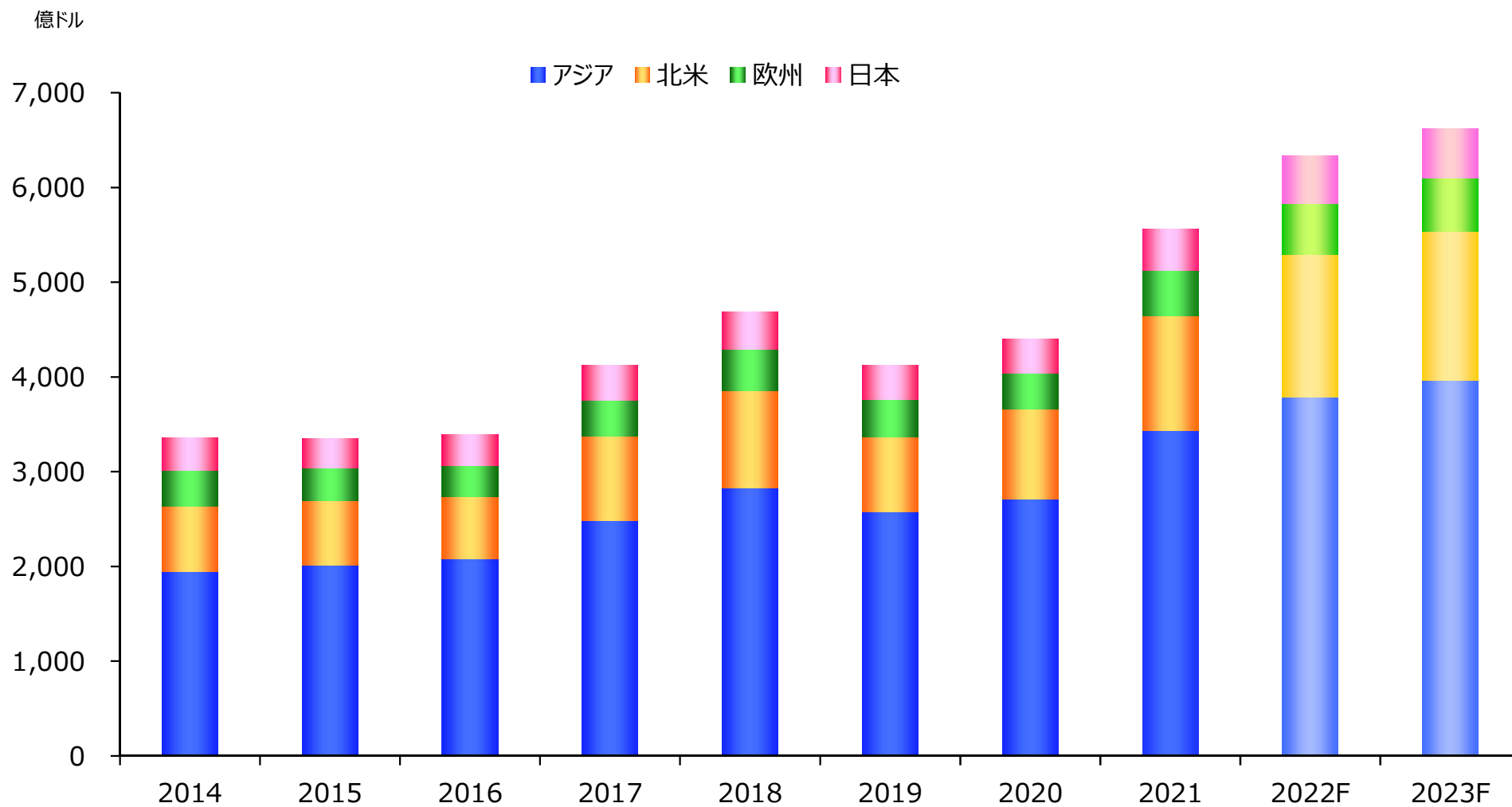
百平方インチ



《暦年ベース》

半導体市場規模（地域別）

出所：WSTS（2022/8/22）



《暦年ベース》